

stor
CA1
EA10
97T42
EXF



CANADA

TREATY SERIES **1997/42** RECUEIL DES TRAITÉS

TRADE

Acceptance of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (with Annexes)

Singapore, December 13, 1996

Acceptance by Canada March 26, 1997

In force for Canada April 1, 1997

COMMERCE

Acceptation de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information (avec Annexes)

Singapour, le 13 décembre 1996

Acceptation du Canada le 26 mars 1997

En vigueur pour le Canada le 1^{er} avril 1997

PLEASE RETURN TO THE TREATY SECTION
VEUILLEZ RENVOYER À LA SECTION DES TRAITÉS

6219100151 1510065129
621910065129



CANADA

Dept. of Foreign Affairs
Min. des Affaires étrangères

AOUT 16 2001
AUG 16 2001

Return to Departmental Library
Retourner à la bibliothèque du Ministère

TREATY SERIES 1997/42 RECUEIL DES TRAITÉS

TRADE

Acceptance of the Ministerial Declaration on Trade in Information
Technology Products (with Annexes)

Singapore, December 13, 1996

Acceptance by Canada March 26, 1997

In force for Canada April 1, 1997

COMMERCE

Acceptation de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits
des technologies de l'information (avec Annexes)

Singapour, le 13 décembre 1996

Acceptation du Canada le 26 mars 1997

En vigueur pour le Canada le 1^{er} avril 1997

62191001(E)
62191001(E)

WORLD TRADE
ORGANIZATION

WT/MIN(96)/16
13 December 1996

(96-5438)

MINISTERIAL CONFERENCE
Singapore, 9-13 December 1996

MINISTERIAL DECLARATION ON TRADE IN
INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS

SINGAPORE, 13 DECEMBER 1996

Ministers,

Representing the following Members of the World Trade Organization ("WTO"), and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, which have agreed in Singapore on the expansion of world trade in information technology products and which account for well over 80 per cent of world trade in these products ("parties"):

Australia
Canada
European Communities
Hong Kong
Iceland
Indonesia
Japan
Korea

Norway
Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen and Matsu
Singapore
Switzerland¹
Turkey
United States

Considering the key role of trade in information technology products in the development of information industries and in the dynamic expansion of the world economy,

Recognizing the goals of raising standards of living and expanding the production of and trade in goods;

Desiring to achieve maximum freedom of world trade in information technology products;

Desiring to encourage the continued technological development of the information technology industry on a world-wide basis;

Mindful of the positive contribution information technology makes to global economic growth and welfare;

¹On behalf of the customs union Switzerland and Liechtenstein.

ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE

WT/MIN(96)/16
13 décembre 1996

(96-5438)

CONFERENCE MINISTERIELLE
Singapour, 9-13 décembre 1996

DECLARATION MINISTERIELLE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS
DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

SINGAPOUR, 13 DECEMBRE 1996

Les Ministres,

Représentant les Membres ci-après de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC"), et les Etats ou territoires douaniers distincts ci-après ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, qui se sont mis d'accord à Singapour sur l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information et qui représentent nettement plus de 80 pour cent du commerce mondial de ces produits (les "parties"),

Australie	Japon
Canada	Norvège
Communautés européennes	Singapour
Corée	Suisse ¹
Etats-Unis	Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu,
Hong Kong	Kinmen et Matsu
Indonésie	Turquie
Islande	

Considérant le rôle-clé joué par le commerce des produits des technologies de l'information dans le développement des industries de l'information et l'expansion dynamique de l'économie mondiale,

Tenant compte des objectifs du relèvement des niveaux de vie et de l'accroissement de la production et du commerce de marchandises,

Désireux d'arriver à une liberté maximale du commerce mondial des produits des technologies de l'information,

Désireux d'encourager la poursuite du développement technologique de l'industrie des technologies de l'information à l'échelle mondiale,

Conscients de la contribution positive que les technologies de l'information apportent à la croissance économique et au bien-être mondiaux,

Etant convenus de donner effet aux résultats de ces négociations qui englobent des concessions s'ajoutant à celles qui sont incluses dans les Listes annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et

¹Au nom de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein.

Having agreed to put into effect the results of these negotiations which involve concessions additional to those included in the Schedules attached to the Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and

Recognizing that the results of these negotiations also involve some concessions offered in negotiations leading to the establishment of Schedules annexed to the Marrakesh Protocol,

Declare as follows:

1. Each party's trade regime should evolve in a manner that enhances market access opportunities for information technology products.
2. Pursuant to the modalities set forth in the Annex to this Declaration, each party shall bind and eliminate customs duties and other duties and charges of any kind, within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, with respect to the following:
 - (a) all products classified (or classifiable) with Harmonized System (1996) ("HS") headings listed in Attachment A to the Annex to this Declaration; and
 - (b) all products specified in Attachment B to the Annex to this Declaration, whether or not they are included in Attachment A;

through equal rate reductions of customs duties beginning in 1997 and concluding in 2000, recognizing that extended staging of reductions and, before implementation, expansion of product coverage may be necessary in limited circumstances.

3. Ministers express satisfaction about the large product coverage outlined in the Attachments to the Annex to this Declaration. They instruct their respective officials to make good faith efforts to finalize plurilateral technical discussions in Geneva on the basis of these modalities, and instruct these officials to complete this work by 31 January 1997, so as to ensure the implementation of this Declaration by the largest number of participants.
4. Ministers invite the Ministers of other Members of the WTO, and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, to provide similar instructions to their respective officials, so that they may participate in the technical discussions referred to in paragraph 3 above and participate fully in the expansion of world trade in information technology products.

Annex: Modalities and Product Coverage
 Attachment A: list of HS headings
 Attachment B: list of products

WT/MIN(96)/16

Page 2

Reconnaissant que les résultats de ces négociations englobent aussi certaines concessions offertes dans les négociations aboutissant à l'établissement des Listes annexées au Protocole de Marrakech,

Déclarent ce qui suit:

1. Le régime commercial de chaque partie devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d'accès aux marchés pour les produits des technologies de l'information.
2. Conformément aux modalités énoncées dans l'Annexe de la présente déclaration, chaque partie consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, pour les produits ci-après:
 - a) tous les produits classés (ou pouvant être classés) dans les positions du Système harmonisé de 1996 ("SH") dont la liste figure dans l'Appendice A de l'Annexe de la présente déclaration; et
 - b) tous les produits spécifiés dans l'Appendice B de l'Annexe de la présente déclaration, qu'ils soient ou non inclus dans l'Appendice A,

par le jeu de réductions égales des taux des droits de douane qui commenceront en 1997 et se termineront en 2000, en reconnaissant qu'un échelonnement des réductions sur une période plus longue et, avant la mise en oeuvre, un élargissement du champ des produits visés pourront être nécessaires dans des circonstances limitées.

3. Les Ministres expriment leur satisfaction au sujet du large champ des produits visés repris dans les Appendices de l'Annexe de la présente déclaration. Ils donnent pour instructions à leurs représentants respectifs de s'efforcer de bonne foi de mener à terme les discussions techniques plurilatérales à Genève sur la base de ces modalités, et leur donnent pour instructions d'achever ces travaux pour le 31 janvier 1997, de manière que la présente déclaration soit mise en oeuvre par le plus grand nombre de participants.

4. Les Ministres invitent les Ministres des autres Membres de l'OMC, et des Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, à donner des instructions similaires à leurs représentants respectifs, de manière qu'ils puissent participer aux discussions techniques mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et participer pleinement à l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information.

Annexe: Modalités et produits visés

Appendice A: liste des positions du SH

Appendice B: liste des produits

ANNEX

Modalities and Product Coverage

Any Member of the World Trade Organization, or State or separate customs territory in the process of acceding to the WTO, may participate in the expansion of world trade in information technology products in accordance with the following modalities:

1. Each participant shall incorporate the measures described in paragraph 2 of the Declaration into its schedule to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and, in addition, at either its own tariff line level or the Harmonized System (1996) ("HS") 6-digit level in either its official tariff or any other published versions of the tariff schedule, whichever is ordinarily used by importers and exporters. Each participant that is not a Member of the WTO shall implement these measures on an autonomous basis, pending completion of its WTO accession, and shall incorporate these measures into its WTO market access schedule for goods.

2. To this end, as early as possible and no later than 1 March 1997 each participant shall provide all other participants a document containing (a) the details concerning how the appropriate duty treatment will be provided in its WTO schedule of concessions, and (b) a list of the detailed HS headings involved for products specified in Attachment B. These documents will be reviewed and approved on a consensus basis and this review process shall be completed no later than 1 April 1997. As soon as this review process has been completed for any such document, that document shall be submitted as a modification to the Schedule of the participant concerned, in accordance with the Decision of 26 March 1980 on Procedures for Modification and Rectification of Schedules of Tariff Concessions (BISD 27S/25).

- (a) The concessions to be proposed by each participant as modifications to its Schedule shall bind and eliminate all customs duties and other duties and charges of any kind on information technology products as follows:
 - (i) elimination of such customs duties shall take place through rate reductions in equal steps, except as may be otherwise agreed by the participants. Unless otherwise agreed by the participants, each participant shall bind all tariffs on items listed in the Attachments no later than 1 July 1997, and shall make the first such rate reduction effective no later than 1 July 1997, the second such rate reduction no later than 1 January 1998, and the third such rate reduction no later than 1 January 1999, and the elimination of customs duties shall be completed effective no later than 1 January 2000. The participants agree to encourage autonomous elimination of customs duties prior to these dates. The reduced rate should in each stage be rounded off to the first decimal; and
 - (ii) elimination of such other duties and charges of any kind, within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement, shall be completed by 1 July 1997, except as may be otherwise specified in the participant's document provided to other participants for review.
- (b) The modifications to its Schedule to be proposed by a participant in order to implement its binding and elimination of customs duties on information technology products shall achieve this result:
 - (i) in the case of the HS headings listed in Attachment A, by creating, where appropriate, sub-divisions in its Schedule at the national tariff line level; and

ANNEXEModalités et produits visés

Tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou tout Etat ou territoire douanier distinct ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, pourra participer à l'expansion du commerce mondial des produits des technologies de l'information conformément aux modalités ci-après:

1. Chaque participant incorporera les mesures décrites au paragraphe 2 de la Déclaration dans sa liste annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aussi, soit au niveau de la ligne tarifaire de son propre tarif soit au niveau à six chiffres du Système harmonisé de 1996 ("SH"), dans son tarif officiel ou dans toute autre version publiée du tarif douanier, selon ce qu'utilisent normalement les importateurs et les exportateurs. Chaque participant non Membre de l'OMC mettra en oeuvre ces mesures sur une base autonome en attendant d'avoir achevé son processus d'accession à l'OMC et les incorporera dans sa liste concernant l'accès au marché pour les marchandises établie dans le cadre de l'OMC.

2. A cette fin, le plus tôt possible et au plus tard le 1er mars 1997, chaque participant communiquera à tous les autres participants un document contenant a) une description détaillée de la manière dont le traitement tarifaire approprié sera prévu dans sa liste de concessions établie dans le cadre de l'OMC, et b) une liste des positions détaillées du SH visées pour les produits spécifiés dans l'Appendice B. Ces documents seront examinés et approuvés par consensus, et ce processus d'examen sera achevé au plus tard le 1er avril 1997. Dès que ce processus d'examen sera achevé pour tout document de cette nature, le document en question sera présenté en tant que modification de la Liste du participant concerné, conformément à la Décision du 26 mars 1980 intitulée "Procédures de modification et de rectification des Listes de concessions tarifaires" (IBDD, S27/26).

- a) Les concessions qui seront proposées par chaque participant en tant que modifications de sa Liste consolideront et élimineront tous les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature sur les produits des technologies de l'information de la manière suivante:
 - i) l'élimination de ces droits de douane se fera par le jeu de réductions des taux opérées par tranches égales, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les participants. A moins qu'il n'en soit convenu autrement par les participants, chaque participant consolidera tous les droits de douane sur les produits dont la liste figure dans les Appendices au plus tard le 1er juillet 1997, et donnera effet à la première de ces réductions de taux au plus tard le 1er juillet 1997, à la deuxième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1998, et à la troisième de ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1999, et l'élimination des droits de douane sera achevée au plus tard le 1er janvier 2000. Les participants conviennent d'encourager l'élimination autonome des droits de douane avant ces dates. Le taux réduit devrait à chaque étape être arrondi à la première décimale; et
 - ii) l'élimination de ces autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'article II:1 b) de l'Accord général, sera achevée pour le 1er juillet 1997, à moins que le document communiqué par le participant aux autres participants pour examen n'en dispose autrement.

- (ii) in the case of the products specified in Attachment B, by attaching an annex to its Schedule including all products in Attachment B, which is to specify the detailed HS headings for those products at either the national tariff line level or the HS 6-digit level.

Each participant shall promptly modify its national tariff schedule to reflect the modifications it has proposed, as soon as they have entered into effect.

3. Participants shall meet periodically under the auspices of the Council on Trade in Goods to review the product coverage specified in the Attachments, with a view to agreeing, by consensus, whether in the light of technological developments, experience in applying the tariff concessions, or changes to the HS nomenclature, the Attachments should be modified to incorporate additional products, and to consult on non-tariff barriers to trade in information technology products. Such consultations shall be without prejudice to rights and obligations under the WTO Agreement.

4. Participants shall meet as soon as practicable and in any case no later than 1 April 1997 to review the state of acceptances received and to assess the conclusions to be drawn therefrom. Participants will implement the actions foreseen in the Declaration provided that participants representing approximately 90 per cent of world trade² in information technology products have by then notified their acceptance, and provided that the staging has been agreed to the participants' satisfaction. In assessing whether to implement actions foreseen in the Declaration, if the percentage of world trade represented by participants falls somewhat short of 90 per cent of world trade in information technology products, participants may take into account the extent of the participation of States or separate customs territories representing for them the substantial bulk of their own trade in such products. At this meeting the participants will establish whether these criteria have been met.

5. Participants shall meet as often as necessary and no later than 30 September 1997 to consider any divergence among them in classifying information technology products, beginning with the products specified in Attachment B. Participants agree on the common objective of achieving, where appropriate, a common classification for these products within existing HS nomenclature, giving consideration to interpretations and rulings of the Customs Co-operation Council (also known as the World Customs Organization or "WCO"). In any instance in which a divergence in classification remains, participants will consider whether a joint suggestion could be made to the WCO with regard to updating existing HS nomenclature or resolving divergence in interpretation of the HS nomenclature.

6. The participants understand that Article XXIII of the General Agreement will address nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to a WTO Member participant through the implementation of this Declaration as a result of the application by another WTO Member participant of any measure, whether or not that measure conflicts with the provisions of the General Agreement.

7. Each participant shall afford sympathetic consideration to any request for consultation from any other participant concerning the undertakings set out above. Such consultations shall be without prejudice to rights and obligations under the WTO Agreement.

8. Participants acting under the auspices of the Council for Trade in Goods shall inform other Members of the WTO and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO of these modalities and initiate consultations with a view to facilitate their participation in the expansion of trade in information technology products on the basis of the Declaration.

²This percentage shall be calculated by the WTO Secretariat on the basis of the most recent data available at the time of the meeting.

- b) Les modifications qu'un participant proposera d'apporter à sa Liste pour mettre en oeuvre la consolidation et l'élimination de ses droits de douane sur les produits des technologies de l'information arriveront à ce résultat:
- i) dans le cas des positions du SH dont la liste figure dans l'Appendice A, par la création, le cas échéant, de subdivisions dans sa Liste au niveau de la ligne tarifaire du tarif national; et
 - ii) dans le cas des produits spécifiés dans l'Appendice B, par l'adjonction d'une annexe à sa Liste incluant tous les produits de l'Appendice B, qui devra spécifier les positions détaillées du SH pour ces produits, soit au niveau de la ligne tarifaire du tarif national, soit au niveau à six chiffres du SH.

Chaque participant modifiera dans les moindres délais son tarif national pour tenir compte des modifications qu'il aura proposées, dès qu'elles seront entrées en vigueur.

3. Les participants se réuniront périodiquement sous les auspices du Conseil du commerce des marchandises pour examiner les produits visés spécifiés dans les Appendices, en vue de déterminer par consensus si, compte tenu des progrès technologiques, de l'expérience acquise dans l'application des concessions tarifaires ou des modifications apportées à la nomenclature du SH, il conviendrait de modifier les Appendices pour y incorporer des produits additionnels, et pour se consulter au sujet des obstacles non tarifaires au commerce des produits des technologies de l'information. Ces consultations seront sans préjudice des droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC.

4. Les participants se réuniront le plus tôt possible et en tout état de cause le 1er avril 1997 au plus tard pour examiner la situation des acceptations reçues et évaluer les conclusions qui en seront tirées. Les participants mettront en oeuvre les mesures prévues dans la Déclaration à condition que des participants représentant environ 90 pour cent du commerce mondial² des produits des technologies de l'information aient alors notifié leur acceptation, et à condition que l'échelonnement ait été convenu à la satisfaction des participants. Lorsqu'ils évalueront s'il y a lieu de mettre en oeuvre les mesures prévues dans la Déclaration, au cas où le pourcentage du commerce mondial représenté par les participants serait légèrement inférieur à 90 pour cent du commerce mondial des produits des technologies de l'information, les participants pourront tenir compte du niveau de participation des Etats ou territoires douaniers distincts représentant pour eux l'essentiel de leur propre commerce de ces produits. A cette réunion, les participants détermineront s'il a été satisfait à ces critères.

5. Les participants se réuniront aussi souvent qu'il sera nécessaire et au plus tard le 30 septembre 1997 pour examiner toute divergence existant entre eux dans la façon de classer les produits des technologies de l'information, en commençant par les produits spécifiés dans l'Appendice B. Les participants conviennent que leur objectif commun est d'arriver, dans les cas où cela sera approprié, à une classification commune de ces produits dans le cadre de la nomenclature existante du SH, en prenant en compte les interprétations et décisions du Conseil de coopération douanière (également connu sous le nom d'Organisation mondiale des douanes ou "OMD"). Au cas où une divergence subsisterait dans la classification, les participants étudieront si une suggestion conjointe pourrait être faite à l'OMD en ce qui concerne l'actualisation de la nomenclature existante du SH ou l'élimination de la divergence d'interprétation au sujet de la nomenclature du SH.

²Ce pourcentage sera calculé par le Secrétariat de l'OMC sur la base des données les plus récentes disponibles au moment de la réunion.

9. As used in these modalities, the term "participant" shall mean those Members of the WTO, or States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, that provide the document described in paragraph 2 no later than 1 March 1997.

10. This Annex shall be open for acceptance by all Members of the WTO and any State or any separate customs territory in the process of acceding to the WTO. Acceptances shall be notified in writing to the Director-General who shall communicate them to all participants.

6. Il est entendu pour les participants que l'article XXIII de l'Accord général sera applicable en cas d'annulation ou de réduction d'avantages résultant directement ou indirectement de la mise en oeuvre de la Déclaration pour un Membre de l'OMC participant du fait de l'application par un autre Membre de l'OMC participant d'une mesure, contraire ou non aux dispositions de l'Accord général.
7. Chaque participant examinera avec compréhension toute demande de consultations de tout autre participant concernant les engagements énoncés ci-dessus. Ces consultations seront sans préjudice des droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC.
8. Les participants agissant sous les auspices du Conseil du commerce des marchandises informeront les autres Membres de l'OMC et les Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC des présentes modalités et engageront des consultations en vue de faciliter leur participation à l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information sur la base de la Déclaration.
9. Tel qu'il est utilisé dans les présentes modalités, le terme "participant" désignera les Membres de l'OMC, ou les Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, qui communiquent le document décrit au paragraphe 2 au plus tard le 1er mars 1997.
10. La présente annexe sera ouverte à l'acceptation de tous les Membres de l'OMC et de tout Etat ou de tout territoire douanier distinct ayant engagé le processus d'accession à l'OMC. Les acceptations seront notifiées par écrit au Directeur général qui les communiquera à tous les participants.

There are two attachments to the Annex.

Attachment A lists the HS headings or parts thereof to be covered.

Attachment B lists specific products to be covered by an ITA wherever they are classified in the HS .

Attachment A, Section 1

HS96		HS description
3818		Chemical elements doped for use in electronics, in form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
8469	11	Word processing machines
8470		Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with a calculating function; accounting machines, postage franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating devices; cash registers:
8470	10	Electronic calculators capable of operating without an external source of electric power and pocket size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions
8470	21	Other electronic calculating machines incorporating a printing device
8470	29	Other
8470	30	Other calculating machines
8470	40	Accounting machines
8470	50	Cash registers
8470	90	Other
8471		Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included:
8471	10	Analogue or hybrid automatic data processing machines
8471	30	Portable digital automatic data processing machines, weighing no more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display
8471	41	Other digital automatic data processing machines comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined
8471	49	Other digital automatic data processing machines presented in the form of systems
8471	50	Digital processing units other than those of subheading 8471 41 and 8471 49, whether or not in the same housing one or two of the following types of units : storage units, input units, output units
8471	60	Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing
8471	70	Storage units, including central storage units, optical disk storage units, hard disk drives and magnetic tape storage units
8471	80	Other units of automatic data processing machines
8471	90	Other
ex 8472	90	Automatic teller machines
8473	21	Parts and accessories of the machines of heading No 8470 of the electronic calculating machines of subheading 8470 10, 8470 21 and 8470 29
8473	29	Parts and accessories of the machines of heading No 8470 other than the electronic calculating machines of subheading 8470 10, 8470 21 and 8470 29
8473	30	Parts and accessories of the machines of heading No 8471

WT/MIN(96)/16

Page 6

La présente annexe comporte deux Appendices.

L'Appendice A énumère les positions ou parties de positions du SH devant être couvertes.

L'Appendice B énumère les produits spécifiques devant être couverts par l'ATI, où qu'ils soient classés dans le SH.

Appendice A, section 1

SH de 1996	Désignation des marchandises
3818	Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique
8469.11	Machines pour le traitement des textes
8470	Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses
8470.10	Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
8470.21	Autres machines à calculer électroniques comportant un organe imprimant
8470.29	Autres
8470.30	Autres machines à calculer
8470.40	Machines comptables
8470.50	Caisses enregistreuses
8470.90	Autres
8471	Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
8471.10	Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
8471.30	Machines automatiques de traitement de l'information numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran
8471.41	Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie
8471.49	Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques, se présentant sous forme de systèmes
8471.50	Unités de traitement numériques autres que celles des n° 8471.41 et 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie
8471.60	Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire
8471.70	Unités de mémoire, y compris les unités de mémoire centrales, les unités de mémoire à disques optiques, les unités de mémoire à disques durs et les unités de mémoire à bandes
8471.80	Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

	8473	50	Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the headings Nos. 8469 to 8472
ex	8504	40	Static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
ex	8504	50	Other inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
	8517		Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems; videophones:
	8517	11	Line telephone sets with cordless handsets
	8517	19	Other telephone sets and videophones
	8517	21	Facsimile machines
	8517	22	Teleprinters
	8517	30	Telephonic or telegraphic switching apparatus
	8517	50	Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems
	8517	80	Other apparatus including entry-phone systems
	8517	90	Parts of apparatus of heading 8517
ex	8518	10	Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 10 mm and a height not exceeding 3 mm, for telecommunication use
ex	8518	30	Line telephone handsets
ex	8518	29	Loudspeakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 50 mm, for telecommunication use
	8520	20	Telephone answering machines
	8523	11	Magnetic tapes of a width not exceeding 4 mm
	8523	12	Magnetic tapes of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6,5 mm
	8523	13	Magnetic tapes of a width exceeding 6,5 mm
	8523	20	Magnetic discs
	8523	90	Other
	8524	31	Discs for laser reading systems for reproducing phenomena other than sound or image
ex	8524	39	Other : - for reproducing representations of instructions, data, sound, and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine
	8524	40	Magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image
	8524	91	Media for reproducing phenomena other than sound or image
ex	8424	99	Other : - for reproducing representations of instructions, data, sound, and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine
ex	8525	10	Transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or television
	8525	20	Transmission apparatus incorporating reception apparatus
ex	8525	40	Digital still image video cameras
ex	8527	90	Portable receivers for calling, alerting or paging
ex	8529	10	Aerials or antennae of a kind used with apparatus for radio-telephony and radio-telegraphy

SH de 1996	Désignation des marchandises
8471.90	Autres
ex 8472.90	Machines de guichet automatiques
8473.21	Parties et accessoires des machines du n° 8470, des machines à calculer électroniques des n° 8470.10, 8470.21 et 8470.29
8473.29	Parties et accessoires des machines du n° 8470, autres que les machines à calculer électroniques des n° 8470.10, 8470.21 et 8470.29
8473.30	Parties et accessoires des machines du n° 8471
8473.50	Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des n° 8469 à 8472
ex 8504.40	Convertisseurs statiques pour machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités et pour appareils de télécommunication
ex 8504.50	Autres bobines de réactance et autres selfs pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités et des appareils de télécommunication
8517	Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones
8517.11	Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
8517.19	Autres postes téléphoniques d'usagers et visiophones
8517.21	Télécopieurs
8517.22	Téléscripteurs
8517.30	Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie
8517.50	Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
8517.80	Autres appareils, y compris les parlophones
8517.90	Parties d'appareils du n° 85.17
ex 8518.10	Microphones ayant une bande passante de 300 Hz à 3,4 KHz; dont le diamètre n'excède pas 10 mm et la hauteur n'excède pas 3 mm, utilisés dans les télécommunications
ex 8518.30	Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil
ex 8518.29	Haut-parleurs, sans enceintes, ayant une bande passante de 300 Hz à 3,4 KHz, dont le diamètre ne dépasse pas 50 mm, utilisés dans les télécommunications
8520.20	Répondeurs téléphoniques
8523.11	Bandes magnétiques d'une largeur n'excédant pas 4 mm
8523.12	Bandes magnétiques d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm
8523.13	Bandes magnétiques d'une largeur excédant 6,5 mm
8523.20	Disques magnétiques

WT/MIN(96)/16

Page 8

ex	8529	90	Parts of: transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or television transmission apparatus incorporating reception apparatus digital still image video cameras, portable receivers for calling, alerting or paging
	8531	20	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
ex	8531	90	Parts of apparatus of subheading 8531 20
	8532		Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set):
	8532	10	Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0,5 kvar (power capacitors)
	8532	21	Tantalum fixed capacitors
	8532	22	Aluminium electrolytic fixed capacitors
	8532	23	Ceramic dielectric, single layer fixed capacitors
	8532	24	Ceramic dielectric, multilayer fixed capacitors
	8532	25	Dielectric fixed capacitors of paper or plastics
	8532	29	Other fixed capacitors
	8532	30	Variable or adjustable (pre-set) capacitors
	8532	90	Parts
	8533		Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors:
	8533	10	Fixed carbon resistors, composition or film types
	8533	21	Other fixed resistors for a power handling capacity not exceeding 20 W
	8533	29	Other fixed resistors for a power handling capacity of 20 W or more
	8533	31	Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a power handling capacity not exceeding 20 W
	8533	39	Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a power handling capacity of 20 W or more
	8533	40	Other variable resistors, including rheostats and potentiometers
	8533	90	Parts
	8534		Printed circuits
ex	8536	50	Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits (Insulated thyristor AC switches)
ex	8536	50	Electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) for a voltage not exceeding 1000 volts
ex	8536	50	Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 amps
ex	8536	69	Plugs and sockets for co-axial cables and printed circuits
ex	8536	90	Connection and contact elements for wires and cables
	8541		Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals:
	8541	10	Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes
	8541	21	Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rate of less than 1 W
	8541	29	Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rate of 1 W or more

SH de 1996	Désignation des marchandises
8523.30	Cartes munies d'une piste magnétique
8523.90	Autres
8524.31	Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
8524.32	Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser pour la reproduction du son uniquement
ex 8524.39	Autres: - pour la reproduction d'ensembles d'instructions, de données, de sons ou d'images, enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information
8524.40	Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
8524.60	Cartes munies d'une piste magnétique
8524.91	Supports pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image
ex 8524.99	Autres: - pour la reproduction d'ensembles d'instructions, de données, de sons et d'images, enregistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information
ex 8525.10	Appareils d'émission autres que pour la radiodiffusion ou la télévision
8525.20	Appareils d'émission incorporant un appareil de réception
ex 8525.40	Appareils de prise de vues fixes vidéo numériques
ex 8527.90	Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes
ex 8529.10	Antennes des types utilisés avec les appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie
ex 8529.90	Parties des appareils suivants: appareils d'émission autres que pour la radiodiffusion ou la télévision appareils d'émission incorporant un appareil de réception appareils de prise de vues fixes vidéo numériques récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes
8531.20	Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)
ex 8531.90	Parties d'appareils du n° 8531.20
8532	Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
8532.10	Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)
8532.21	Condensateurs fixes au tantale
8532.22	Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium

	8541	30	Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices
	8541	40	Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes
	8541	50	Other semiconductor devices
	8541	60	Mounted piezo-electric crystals
	8541	90	Parts
	8542		Electronic integrated circuits and microassemblies
	8542	12	Cards incorporating an electronic integrated circuit ('smart' cards)
	8542	13	Metal oxide semiconductors (MOS technology)
	8542	14	Circuits obtained by bipolar technology
	8542	19	Other monolithic digital integrated circuits, including circuits obtained by a combination of bipolar and MOS technologies (BIMOS technology)
	8542	30	Other monolithic integrated circuits
	8542	40	Hybrid integrated circuits
	8542	50	Electronic microassemblies
	8542	90	Part
	8543	81	Proximity cards and tags
ex	8543	89	Electrical machines with translation or dictionary functions
ex	8544	41	Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
ex	8544	49	Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, not fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
ex	8544	51	Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V, fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
	8544	70	Optical fibre cables
	9009	11	Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process)]
	9009	21	Other photocopying apparatus, incorporating an optical system
	9009	90	Parts and accessories
	9026		Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading No 9014, 9015, 9028 or 9032:
	9026	10	Instruments for measuring or checking the flow or level of liquids
	9026	20	Instruments and apparatus for measuring or checking pressure
	9026	80	Other instruments and apparatus for measuring or checking of heading 9026
	9026	90	Parts and accessories of instruments and apparatus of heading 9026
	9027	20	Chromatographs and electrophoresis instruments
	9027	30	Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR)
	9027	50	Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR) of heading No 9027
	9027	80	Other instruments and apparatus of heading No 9027 (other than those of heading No 9027 10)
ex	9027	90	Parts and accessories of products of heading 9027, other than for gas or smoke analysis apparatus and microtomes

SH de 1996	Désignation des marchandises
8532.23	Condensateurs fixes à diélectrique en céramique, à une seule couche
8532.24	Condensateurs fixes à diélectrique en céramique, multicouches
8532.25	Condensateurs fixes à diélectrique en papier ou en matières plastiques
8532.29	Autres condensateurs fixes
8532.30	Condensateurs variables ou ajustables
8532.90	Parties
8533	Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
8533.10	Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche
8533.21	Autres résistances fixes pour une puissance n'excédant pas 20 W
8533.29	Autres résistances fixes pour une puissance égale ou supérieure à 20 W
8533.31	Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées pour une puissance n'excédant pas 20 W
8533.39	Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées pour une puissance égale ou supérieure à 20 W
8533.40	Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
8533.90	Parties
8534	Circuits imprimés
ex 8536.50	Commutateurs électroniques CA comportant des circuits d'entrée et de sortie couplés optiquement (commutateurs CA, à thyristor, isolés)
ex 8536.50	Commutateurs électroniques, y compris les commutateurs électroniques à protection thermique comportant un transistor et un microcircuit logique (technologie hybride) pour une tension n'excédant pas 1 000 volts
ex 8536.50	Commutateurs électromécaniques à drain pour une intensité n'excédant pas 11 ampères
ex 8536.69	Fiches et prises de courant pour câbles coaxiaux et circuits imprimés
ex 8536.90	Connexions et éléments de contacts pour fils et câbles
8541	Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
8541.10	Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
8541.21	Transistors, autres que les photo-transistors à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W
8541.29	Transistors, autres que les photo-transistors à pouvoir de dissipation égal ou supérieur à 1 W
8541.30	Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles
8541.40	Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

Table 1

Year	Value
1970	100
1971	105
1972	110
1973	115
1974	120
1975	125
1976	130
1977	135
1978	140
1979	145
1980	150
1981	155
1982	160
1983	165
1984	170
1985	175
1986	180
1987	185
1988	190
1989	195
1990	200
1991	205
1992	210
1993	215
1994	220
1995	225
1996	230
1997	235
1998	240
1999	245
2000	250
2001	255
2002	260
2003	265
2004	270
2005	275
2006	280
2007	285
2008	290
2009	295
2010	300
2011	305
2012	310
2013	315
2014	320
2015	325
2016	330
2017	335
2018	340
2019	345
2020	350

SH de 1996	Désignation des marchandises
8541.50	Autres dispositifs à semi-conducteur
8541.60	Cristaux piézo-électriques montés
8541.90	Parties
8542	Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
8542.12	Cartes munies d'un circuit intégré électronique ("cartes intelligentes")
8542.13	Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS)
8542.14	Circuits obtenus par technologie bipolaire
8542.19	Autres circuits intégrés monolithiques numériques, y compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire (technologie BIMOS)
8542.30	Autres circuits intégrés monolithiques
8542.40	Circuits intégrés hybrides
8542.50	Micro-assemblages électroniques
8542.90	Parties
8543.81	Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité
ex 8543.89	Machines électriques ayant des fonctions traduction ou dictionnaire
ex 8544.41	Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 volts, munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
ex 8544.49	Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 volts, non munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
ex 8544.51	Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 volts mais n'excédant pas 1 000 volts, munis de pièces de connexion, des types utilisés dans les télécommunications
8544.70	Câbles de fibres optiques
9001.10	Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques
ex 9009.12	Appareils de photocopie électrostatiques numériques fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)
ex 9009.21	Autres appareils de photocopie numériques, à système optique
9009.90	Parties et accessoires
9026	Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n° 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32
9026.10	Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
9026.20	Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression
9026.80	Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du n° 90.26

WT/MIN(96)/16

Page 10

9030	40	Instruments and apparatus for measuring and checking, specially designed for telecommunications (for example, cross-talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, psophometers)
------	----	--

WT/MIN(96)/16

Page 12

SH de 1996	Désignation des marchandises
9026.90	Parties et accessoires d'instruments et appareils du n° 90.26
9027.20	Chromatographes et appareils d'électrophorèse
9027.30	Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)
9027.50	Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) du n° 90.27
9027.80	Autres instruments et appareils du n° 90.27 (autres que ceux du n° 9027.10)
ex 9027.90	Parties et accessoires des produits du n° 90.27, autres que les analyseurs de gaz ou de fumées et les microtomes
9030.40	Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

Attachment A, Section 2

Semiconductor manufacturing and testing equipment and parts thereof

	HS Code	Description	Comments
ex	7017 10	Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8419 89	Chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8419 90	Parts of chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8421 19	Spin dryers for semiconductor wafer processing	
ex	8421 91	Parts of spin dryers for semiconductor wafer processing	
ex	8424 89	Deflash machines for cleaning and removing contaminants from the metal leads of semiconductor packages prior to the electroplating process	
ex	8424 89	Spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers	
ex	8424 90	Parts of spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers	
ex	8456 10	Machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers	
ex	8456 91	Apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers	For Attachment B
	8456 91	Machines for dry-etching patterns on semiconductor materials	
ex	8456 99	Focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	
ex	8456 99	Laser cutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam	For Attachment B
ex	8464 10	Machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips	For Attachment B
ex	8464 20	Grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	
ex	8464 90	Dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers	
ex	8466 91	Parts for machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips	For Attachment B
ex	8466 91	Parts of dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8466 91	Parts of grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	
ex	8466 93	Parts of focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	
ex	8466 93	Parts of laser cutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam	For Attachment B
ex	8466 93	Parts of machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers	
ex	8456 93	Parts of apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8466 93	Parts of machines for dry-etching patterns on semiconductor materials	
ex	8477 10	Encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8477 90	Parts of encapsulation equipment	For Attachment B

Appendice A, section 2

Matériel de fabrication et d'essai de semi-conducteurs et parties de ce matériel

Code SH	Désignation	Observations
ex 7017.10	Tubes réacteurs à quartz et supports pour insertion dans des fours de diffusion et fours à oxydation pour la production de plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8419.89	Appareils de métallisation chimique sous vide pour la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8419.90	Parties d'appareils de métallisation chimique sous vide pour la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8421.19	Centrifugeuses pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8421.91	Parties de centrifugeuses pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8424.89	Machines d'ébavurage pour nettoyer les fils de sortie métalliques d'ensembles de semi-conducteurs et enlever les contaminants avant les opérations de galvanoplastie	
ex 8424.89	Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8424.90	Parties de pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8456.10	Machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, destinées à la production de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8456.91	Appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
8456.91	Machines pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices	
ex 8456.99	Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées à la production ou à la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteurs	
ex 8456.99	Machines à laser pour le découpage par rayons laser des pistes de contact, destinées à la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8464.10	Machines à scier pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou de plaquettes en microplaquettes	Pour l'Appendice B
ex 8464.20	Machines à meuler, à polir et à roder pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8464.90	Machines de découpage en dés pour le grattage ou le rainurage des plaquettes à semi-conducteurs	

WT/MIN(96)/16

Page 12

ex	8479 50	Automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices	For Attachment B
ex	8479 89	Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	
ex	8479 89	Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 89	Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8479 89	Die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 89	Encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 89	Epitaxial deposition machines for semiconductor wafers	
ex	8479 89	Machines for bending, folding and straightening semiconductor leads	For Attachment B
ex	8479 89	Physical deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8479 89	Spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Part of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Parts for die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 90	Parts for spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	
ex	8479 90	Parts of apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of epitaxial deposition machines for semiconductor wafers	
ex	8479 90	Parts of machines for bending, folding and straightening semiconductor leads	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of physical deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8480 71	Injection and compression moulds for the manufacture of semiconductor devices	
ex	8514 10	Resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 20	Inductance or dielectric furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 30	Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8514 30	Parts of resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 90	Parts of apparatus for rapid heating of wafers	For Attachment B
ex	8514 90	Parts of furnaces and ovens of Headings No 8514 10 to No 8514 30	
ex	8536 90	Wafer probes	For Attachment B
	8543 11	Ion implanters for doping semiconductor materials	
ex	8543 30	Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B

Code SH	Désignation	Observations
ex 8466.91	Parties de machines à scier pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou de plaquettes en microplaquettes	Pour l'Appendice B
ex 8466.91	Parties de machines de découpage en dés pour le grattage ou le rainurage des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.91	Parties de machines à meuler, à polir ou à roder pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8466.93	Parties de fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées à la production ou à la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteurs	
ex 8466.93	Parties de machines à laser pour le découpage par rayon laser des pistes de contact, destinées à la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.93	Parties de machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, destinées à la production de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8456.93	Parties d'appareils pour le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8466.93	Parties de machines pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices	
ex 8477.10	Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8477.90	Parties de matériel d'encapsulation	Pour l'Appendice B
ex 8479.50	Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes, de boîtes de plaquettes et d'autres matériaux destinés à des dispositifs à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs	
ex 8479.89	Appareils à dépôt physique par pulvérisation sur les plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs des systèmes d'affichage à écran plat	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils de fixation de puces, appareils de transport automatique sur bande et microsoudes de fils pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Machines à dépôt épitaxial destinées à la fabrication de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8479.89	Machines à souder, à plier et à dresser les fils de sortie de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.89	Appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
1	1/1/50
2	1/2/50
3	1/3/50
4	1/4/50
5	1/5/50
6	1/6/50
7	1/7/50
8	1/8/50
9	1/9/50
10	1/10/50
11	1/11/50
12	1/12/50
13	1/13/50
14	1/14/50
15	1/15/50
16	1/16/50
17	1/17/50
18	1/18/50
19	1/19/50
20	1/20/50
21	1/21/50
22	1/22/50
23	1/23/50
24	1/24/50
25	1/25/50
26	1/26/50
27	1/27/50
28	1/28/50
29	1/29/50
30	1/30/50
31	1/31/50

Code SH	Désignation	Observations
ex 8479.89	Tournettes pour le dépôt d'émulsions photographiques sur les plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation sur les plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties d'appareils de fixation de puces, d'appareils de transport automatique sur bande et de microsoudes de fils pour l'assemblage de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties de tournettes pour le dépôt d'émulsions photographiques sur les plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties d'appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs	
ex 8479.90	Parties d'appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs et des systèmes d'affichage à écran plat	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties de machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes, de boîtes de plaquettes et d'autres matériaux destinés à des dispositifs à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties de matériel d'encapsulation pour l'assemblage des semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties de machines à dépôt épitaxial destinées à la fabrication de plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8479.90	Parties de machines à couder, à plier et à dresser les fils de sortie de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8479.90	Parties d'appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8480.71	Moules pour le moulage par injection ou par compression pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs	
ex 8514.10	Fours à résistance (à chauffage indirect) pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8514.20	Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8514.30	Appareils pour le chauffage rapide des plaquettes à semi-conducteurs	Pour l'Appendice B
ex 8514.30	Parties de fours à résistance (à chauffage indirect) pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur plaquettes à semi-conducteurs	
ex 8514.90	Parties d'appareils pour le traitement thermique rapide des plaquettes	Pour l'Appendice B
ex 8514.90	Parties des fours des positions 8514.10 à 8514.30	
ex 8536.90	Testeurs de plaquettes	Pour l'Appendice B

ex	8543 90	Parts of apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8543 90	Parts of ion implanters for doping semiconductor materials	
	9010 41 to 9010 49	Apparatus for projection, drawing or plating circuit patterns on sensitized semiconductor materials and flat panel displays	
ex	9010 90	Parts and accessories of the apparatus of Headings No 9010 41 to 9010 49	
ex	9011 10	Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011.20	Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011 90	Parts and accessories of optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011 90	Parts and accessories of photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9012 10	Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9012 90	Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9017 20	Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates	For Attachment B
ex	9017 90	Parts and accessories for pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates	For Attachment B
ex	9017 90	Parts of such pattern generating apparatus	For Attachment B
	9030 82	Instruments and apparatus for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
ex	9030 90	Parts and accessories of instruments and apparatus for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
ex	9030 90	Parts of instruments and appliances for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
	9031 41	Optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	
ex	9031 49	Optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	
ex	9031 90	Parts and accessories of optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	
ex	9031 90	Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	

Code SH	Désignation	Observations
8543.11	Appareils d'implantation ionique pour le dopage des matières semi-conductrices	
ex 8543.30	Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs et des systèmes d'affichage à écran plat	Pour l'Appendice B
ex 8543.90	Parties d'appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs et des systèmes d'affichage à écran plat	Pour l'Appendice B
ex 8543.90	Parties d'appareils d'implantation ionique pour le dopage des matières semi-conductrices	
9010.41 à 9010.49	Appareils pour la projection, la réalisation ou le placage des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs et des systèmes d'affichage à écran plat	
ex 9010.90	Parties et accessoires des appareils des positions 9010.41 à 9010.49	
ex 9011.10	Microscopes optiques stéréoscopiques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9011.20	Microscopes pour la photomicrographie pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9011.90	Parties et accessoires de microscopes optiques stéréoscopiques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9011.90	Parties et accessoires de microscopes pour la photomicrographie pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9012.10	Microscopes électroniques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9012.90	Parties et accessoires de microscopes électroniques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules	Pour l'Appendice B
ex 9017.20	Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible	Pour l'Appendice B
ex 9017.90	Parties et accessoires de masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible	Pour l'Appendice B
ex 9017.90	Parties de ces masqueurs	Pour l'Appendice B
9030.82	Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs	

Table 1

Year	Value	Percentage
1950	100	100
1951	105	105
1952	110	110
1953	115	115
1954	120	120
1955	125	125
1956	130	130
1957	135	135
1958	140	140
1959	145	145
1960	150	150
1961	155	155
1962	160	160
1963	165	165
1964	170	170
1965	175	175
1966	180	180
1967	185	185
1968	190	190
1969	195	195
1970	200	200
1971	205	205
1972	210	210
1973	215	215
1974	220	220
1975	225	225
1976	230	230
1977	235	235
1978	240	240
1979	245	245
1980	250	250
1981	255	255
1982	260	260
1983	265	265
1984	270	270
1985	275	275
1986	280	280
1987	285	285
1988	290	290
1989	295	295
1990	300	300
1991	305	305
1992	310	310
1993	315	315
1994	320	320
1995	325	325
1996	330	330
1997	335	335
1998	340	340
1999	345	345
2000	350	350
2001	355	355
2002	360	360
2003	365	365
2004	370	370
2005	375	375
2006	380	380
2007	385	385
2008	390	390
2009	395	395
2010	400	400
2011	405	405
2012	410	410
2013	415	415
2014	420	420
2015	425	425
2016	430	430
2017	435	435
2018	440	440
2019	445	445
2020	450	450
2021	455	455
2022	460	460
2023	465	465
2024	470	470
2025	475	475
2026	480	480
2027	485	485
2028	490	490
2029	495	495
2030	500	500

Code SH	Désignation	Observations
ex 9030.90	Parties et accessoires d'instruments et d'appareils pour la mesure ou le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs	
ex 9030.90	Parties d'instruments et d'appareils pour la mesure ou le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs	
9031.41	Instruments et appareils optiques pour le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs ou pour le contrôle des masques, des photomasques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteurs	
ex 9031.49	Instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des plaquettes à semi-conducteurs	
ex 9031.90	Parties et accessoires d'instruments et appareils optiques pour le contrôle des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs ou pour le contrôle des masques, des photomasques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteurs	
ex 9031.90	Parties et accessoires d'instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des plaquettes à semi-conducteurs	

WT/MIN(96)/16
Page 14

Attachment B

Positive list of specific products to be covered by this agreement wherever they are classified in the HS.

Where parts are specified, they are to be covered in accordance with HS Notes 2(b) to Section XVI and Chapter 90, respectively.

<p>Computers: automatic data processing machines capable of 1) storing the processing program or programs and at least the data immediately necessary for the execution of the program; 2) being freely programmed in accordance with the requirements of the user; 3) performing arithmetical computations specified by the user; and 4) executing, without human intervention, a processing program which requires them to modify their execution, by logical decision during the processing run.</p> <p>The agreement covers such automatic data processing machines whether or not they are able to receive and process with the assistance of central processing unit telephony signals, television signals, or other analogue or digitally processed audio or video signals. Machines performing a specific function other than data processing, or incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine, and not otherwise specified under Attachment A or B, are not covered by this agreement.</p>
<p>Electric amplifiers when used as repeaters in line telephony products falling within this agreement, and parts thereof</p>
<p>Flat panel displays (including LCD, Electro Luminescence, Plasma and other technologies) for products falling within this agreement, and parts thereof.</p>
<p>Network equipment: Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) apparatus, including those products dedicated for use solely or principally to permit the interconnection of automatic data processing machines and units thereof for a network that is used primarily for the sharing of resources such as central processor units, data storage devices and input or output units - including adapters, hubs, in-line repeaters, converters, concentrators, bridges and routers, and printed circuit assemblies for physical incorporation into automatic data processing machines and units thereof.</p>
<p>Monitors : display units of automatic data processing machines with a cathode ray tube with a dot screen pitch smaller than 0,4 mm not capable of receiving and processing television signals or other analogue or digitally processed audio or video signals without assistance of a central processing unit of a computer as defined in this agreement.</p> <p>The agreement does not, therefore, cover televisions, including high definition televisions.³</p>
<p>Optical disc storage units, for automatic data processing machines (including CD drives and DVD-drives), whether or not having the capability of writing/recording as well as reading, whether or not in their own housings.</p>
<p>Paging alert devices, and parts thereof .</p>
<p>Plotters whether input or output units of HS heading No 8471 or drawing or drafting machines of HS heading No 9017.</p>
<p>Printed Circuit Assemblies for products falling within this agreement, including such assemblies for external connections such as cards that conform to the PCMCIA standard.</p> <p>Such printed circuit assemblies consist of one or more printed circuits of heading 8534 with one or more active elements assembled thereon, with or without passive elements "Active elements" means diodes, transistors, and similar semiconductor devices, whether or not photosensitive, of heading 8541, and integrated circuits and micro assemblies of heading 8542.</p>
<p>Projection type flat panel display units used with automatic data processing machines which can display digital information generated by the central processing unit.</p>

³ Participants will conduct a review of this product description in January 1999 under the consultation provisions of paragraph 3 of the Declaration

Appendice B

Liste positive des produits spécifiques devant être couverts par le présent accord, où qu'ils soient classés dans le SH.

Dans les cas où des parties sont spécifiées, elles doivent être couvertes conformément aux Notes 2 b) de la Section XVI et du chapitre 90 du SH, respectivement.

<p>Ordinateurs: machines automatiques de traitement de l'information aptes à 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.</p> <p>L'accord couvre les machines automatiques de traitement de l'information, qu'elles soient ou non aptes à recevoir et à traiter avec l'aide de l'unité centrale de traitement des signaux téléphoniques, des signaux de télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement. Les machines exécutant une fonction spécifique autre que le traitement de l'information ou incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou fonctionnant en association avec une telle machine et qui ne sont pas spécifiées dans l'Appendice A ou B ne sont pas couvertes par le présent accord.</p>
<p>Amplificateurs électriques utilisés comme répéteurs dans des systèmes de téléphonie filaire relevant du présent accord, et leurs parties.</p>
<p>Systèmes d'affichage à écran plat (y compris systèmes à cristaux liquides, à électroluminescence, à plasma et autres) pour les produits relevant du présent accord, et leurs parties.</p>
<p>Equipements de réseaux: appareils pour réseaux locaux (LAN) et grands réseaux (WAN), y compris les produits destinés à être utilisés exclusivement ou principalement pour assurer l'interconnexion de machines automatiques de traitement de l'information et de leurs unités dans un réseau utilisé principalement pour le partage de ressources, tel que unités de traitement central, unités de mémoire et unités d'entrée ou de sortie - y compris adaptateurs, installations nodales, répéteurs de lignes, convertisseurs, concentrateurs, passerelles et routeurs, et assemblage de circuits imprimés pouvant être incorporés dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités.</p>
<p>Moniteurs: unités d'affichage de machines automatiques de traitement de l'information à tube à rayons cathodiques avec un pas de matrice inférieur à 0,4 mm ne pouvant pas recevoir ni traiter des signaux de télévision ou d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement sans l'aide d'une unité centrale de traitement d'ordinateur, telle qu'elle est définie dans le présent accord.</p> <p>L'accord ne couvre donc pas les télévisions, y compris les télévisions à haute définition.³</p>
<p>Unités de mémoire à disques optiques pour machines automatiques de traitement de l'information (y compris unités de disques audionumériques (CD) et de vidéodisques (DVD)), avec ou sans possibilité d'écriture/enregistrement et de lecture sous leur propre enveloppe ou non.</p>
<p>Récepteurs de téléappel et leurs parties.</p>
<p>Traceurs, qu'il s'agisse d'unités d'entrée ou de sortie relevant de la position n° 8471 du SH ou de machines à dessiner ou à tracer relevant de la position n° 9017 du SH.</p>

³Les participants procéderont à un examen de la désignation des produits en janvier 1999 au titre des dispositions relatives aux consultations du paragraphe 3 de l'Annexe.

WT/MIN(96)/16

Page 15

Proprietary format storage devices including media therefor for automatic data processing machines, with or without removable media and whether magnetic, optical or other technology, including Bernoulli Box, Syquest, or Zipdrive cartridge storage units.

Multimedia upgrade kits for automatic data processing machines, and units thereof, put up for retail sale, consisting of, at least, speakers and/or microphones as well as a printed circuit assembly that enables the ADP machines and units thereof to process audio signals (sound cards).

Set top boxes which have a communication function: a microprocessor-based device incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange

Assemblages de circuits imprimés pour les produits relevant du présent accord, y compris pour les connexions extérieures telles que les cartes conformes à la norme PCMCIA.

Ces assemblages de circuits imprimés consistent en un ou plusieurs circuits imprimés relevant de la position n° 8534 comportant chacun un ou plusieurs éléments actifs, avec ou sans éléments passifs. Par éléments actifs, on entend les diodes, transistors et dispositifs semi-conducteurs analogues, qu'ils soient ou non photosensibles, relevant de la position n° 8541, et les circuits intégrés et micro-assemblages relevant de la position n° 8542.

Téléprojecteurs à écran plat utilisés avec des machines automatiques de traitement de l'information qui peuvent afficher des informations numériques produites par l'unité centrale de traitement.

Unités de mémoire de format spécifique, y compris les supports d'information pour machines de traitement automatique de l'information, avec ou sans support amovible, de type magnétique, optique ou autre, y compris les unités de disques à cartouches Bernoulli Box, Syquest ou Zipdrive.

Kits de mise à niveau multimédia pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou des microphones ainsi qu'un assemblage de circuits imprimés permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter des signaux audio (cartes son).

Modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d'accès à Internet et ayant une fonction d'échange interactif d'informations.

Department of Foreign Affairs
and International Trade



Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international

The Deputy Minister for Foreign Affairs certifies that this is a true copy of the *Agreement "Acceptance of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (with Annexes)"*, done at Singapore on December 13, 1996, the original of which is deposited in the Treaty Archives of the Government of Canada.

Le sous-ministre des Affaires étrangères certifie que la présente est une copie conforme de l'*Accord "Acceptation de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information (avec Annexes)"*, fait à Singapour le 13 décembre 1996, dont l'original se trouve déposé au greffe des traités du Gouvernement du Canada.

© Minister of Public Works and Government Services

Canada - 1998

Available in Canada through your local bookseller or
by mail from Canadian Government Publishing -

PWGSC

Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No.: E3-1997/42

ISBN 0-660-61103-1

© Ministre des Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada - 1998

En vente au Canada chez votre libraire local ou par la
poste auprès des Éditions du gouvernement du Canada

- TPSGC

Ottawa, Canada K1A 0S9

N° de catalogue : E3-1997/42

ISBN 0-660-61103-1

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20096360 4

Storage

CA1 EA10 97T42 EXF

Trade : acceptance of the
Ministerial Declaration on Trade i
Information Technology Products
(with Annexes) = Commerce : ac
62191001

